



## **EV Group gewinnt 3D InCites Award als "Equipment Supplier of the Year"**

*Prestigeträchtige Branchenauszeichnung würdigt den bedeutenden Beitrag von EVG zur Weiterentwicklung der Roadmaps im Bereich 3D-IC-Packaging und Heterogeneous Integration*

**ST. FLORIAN, Österreich, 4. März 2020** — EV Group (EVG), ein führender Entwickler und Hersteller von Anlagen für Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie, konnte heute den prestigeträchtigen 3D InCites Award 2020 in der Kategorie "Equipment Supplier of the Year" für sein automatisches Bond Alignment-System SmartView® NT3 entgegennehmen. Das System, erhältlich für EVG's integrierte GEMINI® FB XT Fusionsbonding-Plattform zur Hochvolumenproduktion, bietet unübertroffene Leistungsdaten im Bereich des Waferbondens zur Erfüllung zukünftiger Anforderungen an das 3D-IC-Packaging.

Das 3D InCites Awards-Programm wird von der Online-Plattform 3D InCites veranstaltet, die 2009 gegründet wurde, um das Interesse an der 3D-Integration zu fördern. Mit der Auszeichnung werden bedeutende Beiträge zur Weiterentwicklung der Roadmaps im Bereich der heterogenen Integration, mit Anwendungen wie 3D-Packaging, Interposer-Integration, Fan-out Wafer-Level Packaging, MEMS und Sensoren sowie der Integration kompletter Systeme gewürdigt.

EVG bietet seit mehr als 20 Jahren Lösungen für Advanced Packaging und Heterogeneous Integration an und ermöglichte dadurch unter anderem revolutionäre Technologie-Entwicklungen wie Rückseiten-belichtete CMOS-Bildsensoren (BSI-CIS), das 3-dimensionale bzw. gestapelte Packaging einzelner Dies sowie ultradünne und gestapelte Fan-Out-Packages. Die industrieweit führenden Produkte des Unternehmens zum Waferbonden, zur Dünnwafers-Bearbeitung und für Lithographie-Anwendungen werden von EVGs neu angekündigtem [Heterogeneous Integration Competence Center™](#) ergänzt. Ziel ist, die Kunden beim Einsatz der Prozesslösungen und des Know-hows von EVG zur Realisierung neuer und verbesserter Produkte und Anwendungen, die durch Fortschritte bei der Systemintegration und dem Packaging vorangetrieben werden, zu unterstützen.

"Es ist eine große Ehre für EVG, von Branchenexperten und Fachkollegen für unseren Beitrag zur heterogenen Integration anerkannt zu werden", erklärte Hermann Waltl, Executive Sales and Customer Support Director bei EV Group. "Wir sind stolz auf unser jahrzehntelanges Engagement im Bereich Semiconductor Packaging und arbeiten unermüdlich daran, innovative Prozesslösungen auf den Markt zu bringen, die den Bedarf unserer Kunden nach größerer Designflexibilität, höherer Leistung und niedrigeren Entwicklungs- und Systemkosten unterstützen. Der SmartView NT3 Aligner ist nur eines unserer neuesten, wegweisenden Produkte, die wir im Laufe der Jahre eingeführt haben, um die Roadmaps unserer Kunden fortzuschreiben. So konnten mit dem SmartView NT3 Aligner in Kombination mit unserem GEMINI FB XT zum Beispiel erstmals Overlay-Genauigkeiten im Bereich unter 100 nm beim Wafer-zu-Wafer-Alignment für das Hybrid Bonding demonstriert werden, wodurch Devices wie 3D BSI-CIS und Memory-on-Logic-Stacking ermöglicht wurden."

Der SmartView NT3 Aligner wurde speziell für Fusions- und Hybrid-Bonding-Anwendungen entwickelt. Das System ermöglicht gestapelte Devices mit höherer Packungsdichte und Leistung, geringerem Stromverbrauch und kleinerem Footprint. Das System bietet eine Wafer-to-Wafer Alignmentgenauigkeit von unter 50 nm, was eine Verbesserung um den Faktor 2 bis 3 darstellt, sowie einen deutlich höheren Durchsatz gegenüber der Vorgängerplattform. Zu den Anwendungen gehört das Flash Memory Stacking, 3D Systems on Chip (SoC), Backside-illuminated CMOS Image Sensor Stacking und Die Partitioning.



Mehr Informationen zur Familie der automatischen SmartView NT Bondalignment-Systeme finden Sie unter <https://www.evgroup.com/de/products/bonding/bond-alignment-systems/smartview-nt/>.

### **Über EV Group (EVG)**

Die EV Group (EVG) ist anerkannter Technologie- und Marktführer für Präzisionsanlagen und Prozesslösungen zur Waferbearbeitung in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie. Zu den Kernprodukten gehören Waferbonder, Systeme zur Dünnwafer-Bearbeitung, Lithographie- und Nanoprägelithographie-Systeme sowie Fotoresist-Belacker, Reinigungs- und Metrologiesysteme. Das 1980 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in St. Florian am Inn (Austria) beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter und betreut mit eigenen Niederlassungen in USA, Japan, Korea, China und Taiwan sowie Repräsentanzen namhafte Produktionskunden und R&D-Partner in aller Welt. Mehr Informationen unter [www.EVGroup.com](http://www.EVGroup.com).

### **Kontakte:**

Clemens Schütte  
Director, Marketing and Communications  
EV Group  
Tel: +43 7712 5311 0  
E-Mail: [Marketing@EVGroup.com](mailto:Marketing@EVGroup.com)

David Moreno  
Principal  
Open Sky Communications  
Tel: +1.415.519.3915  
E-mail: [dmoreno@openskypr.com](mailto:dmoreno@openskypr.com)